

新闻稿，面向行业刊物

哈瑙/上海，2018年6月26日

PCIM Asia展会：贺利氏推出具有功率循环能力的全新Die Top System，助力电动汽车发展

半导体与电子行业内领先的材料解决方案提供商贺利氏电子将出席于2018年6月26日至28日举行的上海国际电力元件、可再生能源管理展览会（PCIM Asia），届时将推出全新的电力电子模块芯片接触系统——Die Top System。该系统能够将芯片的载流容量提高50%，从而显著提升芯片的可靠性。在模拟试验中，电动车与混合动力车厂商可以利用Die Top System 测试动力传输极限——这是决定车企能否在中国电动汽车市场上取得成功的一项关键要素。

电动汽车未来发展进程取决于中国的表现。中国市场的一项重要驱动因素就是政府推出的电动汽车配额制：汽车厂商生产的电动车和插电式混合动力车必须达到固定的配额。从2019年起，不论是本土还是外资汽车公司，只要其生产和销售的新能源汽车比例未达到最低定额，就会受到处罚。

提高电可靠性与热稳定性

在上述规定下，电力电子对于汽车厂商而言变得愈发重要。

贺利氏电子将在PCIM Asia展会上推出Die Top System。这一基于Danfoss Bond Buffer®技术的系统可以为硅半导体和碳化硅半导体提供全新的封装与键合技术。

“贺利氏与丹佛斯公司（Danfoss）共同开发的Die Top System非常适合对可靠性要求极高的应用。”贺利氏电子全球业务单元总裁 Klemens Brunner博士解释道，“Die Top System的独特优势将使电动车与混合动力车厂商受益匪浅。他们能够根据其具体需求测试Die Top System的可靠性，并且可以在中国进行现场功率循环测试来检测动力传输极限。”

提高载流容量和功率循环能力

采用最新设计的Die Top System不仅可以提高电力电子模块的载流容量，而且还能将其功率循环能力提升9倍以上。这样，结温最高可以达到200°C。导热性能优异的铜箔通过烧结浆料覆在半导体芯片上，使电流在半导体芯片中均匀分布，从而减少半导体产生的热量，同时更好地平衡热点。此外，铜箔在电力电子模块生产过程中还可以起到芯片补强的作用。这样，高效的铜键合丝就可以取代传统的铝键合丝，从而有望在电力电子模块尺寸不变的情况下将其功率提升50%。

欢迎莅临贺利氏展台：

PCIM Asia展会
2018年6月26日-28日
上海世博展览馆
2号展厅，C05展台。

关于贺利氏电子

贺利氏集团旗下的贺利氏电子全球业务单元是电子行业内领先的集成电路封装材料制造商。公司的电子材料和产品广泛应用于半导体封装、汽车电子、消费电子、能源电子、工业电子和通信电子等领域。贺利氏电子的核心产品包括：键合丝、封装材料、特种厚膜浆料及焊膏、基板和轧辊复合带材等。

关于贺利氏集团

总部位于德国哈瑙市的贺利氏是一家全球领先的科技集团。公司在1660年从家族的一间小药房起家，并于1851年正式成立。如今，贺利氏已发展成为一家产品组合型家族企业，业务涵盖环保、能源、电子、健康、交通及工业应用等诸多领域。

2017年财年，贺利氏的总销售收入为218亿欧元，名列《财富》“世界五百强”，公司目前在40个国家拥有约13,000名员工，在全球市场上占据领导地位。贺利氏还被评选为“德国家族企业十强”。

凭借专业的技术、创新的理念、对卓越的不懈追求以及具有企业家精神的管理团队，我们不断努力提升业绩表现。我们通过发挥材料方面的专长，充分利用贺利氏的技术领导地位，致力于为客户创造高质量的解决方案，帮助他们提升长期竞争力。

大中华地区是贺利氏集团最为重要的三个市场之一，公司在这一地区的发展已有超过40年的历史。目前，贺利氏在大中华地区一共拥有2,600多名员工和20家公司。

媒体联系人

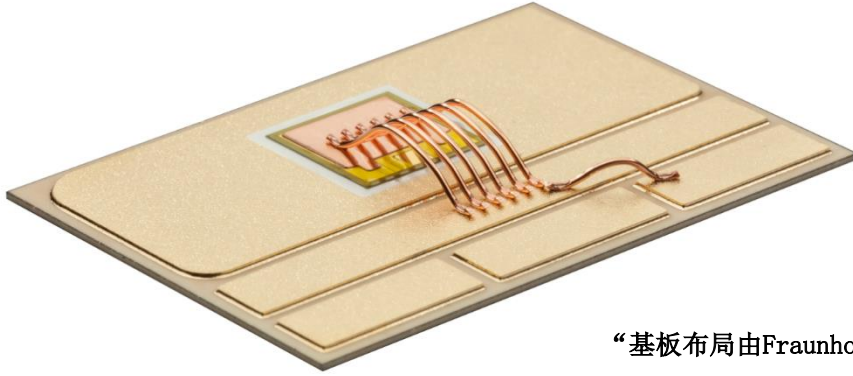
陈立斌

贺利氏大中华地区总部沟通部经理

电话: + 86 21 3357 5261

邮箱: kevin.chen@heraeus.com

网址: www.heraeus.com



“基板布局由Fraunhofer IISB提供”

基于Danfoss Bond Buffer®技术的贺利氏Die Top System专为对可靠性要求极高的应用而设计。